

特点:

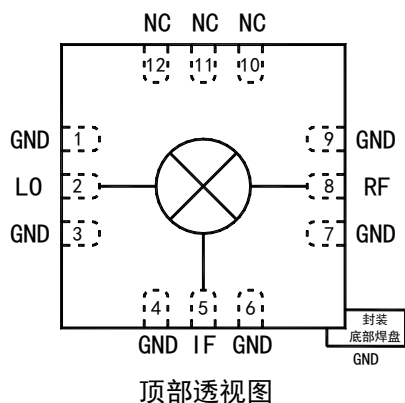
- 射频/本振频率: 7~26GHz
- 中频频率: 0.01~6.0GHz
- 变频损耗: 典型值 11dB
- 本振功率: 典型值+13dBm
- 结构: 无源双平衡
- QFN 封装
- 尺寸: 3.0×3.0×1.2mm

图片:

性能参数: (50Ω系统, T_A= -55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
射频/本振频率	f _{RF/LO}	f _{RF/LO} =7~26GHz f _{IF} =0.01~6.00GHz 本振功率=+13dBm	7		26	GHz	
中频频率	f _{IF}		0.01		6.00	GHz	
变频损耗	IL			11	14	dB	
回波损耗	RL _{RF}		3	12		dB	
	RL _{LO}		3	10		dB	
	RL _{IF}		4	9		dB	
隔离度	ISO _{LO to RF}		22	31		dB	
	ISO _{LO to IF}		24	30		dB	
	ISO _{RF to IF}		6.5	13		dB	
输入-1dB 压缩点	IP _{-1dB}		+8	+12		dBm	
质量	m				1	g	

功能框图:



引脚定义:

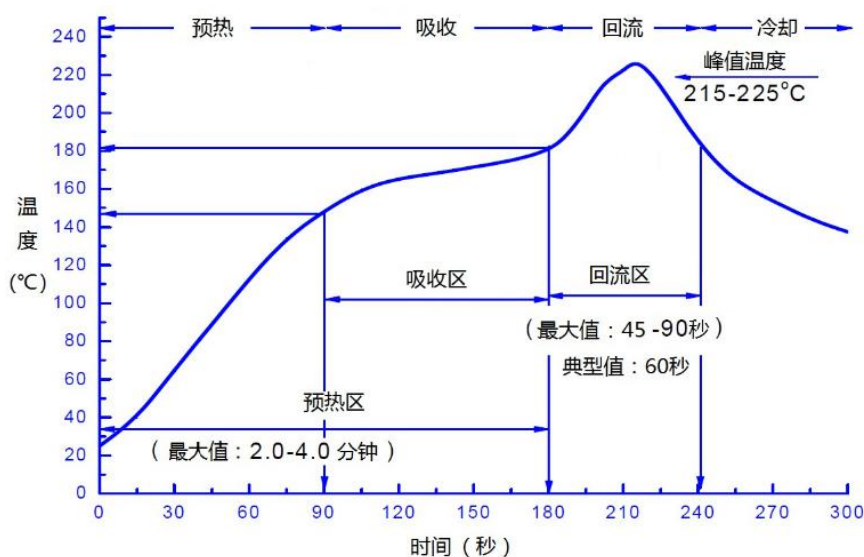
引脚编号	符号	描述
2	LO	本振端口, DC 耦合
8	RF	射频端口, DC 耦合
5	IF	中频端口, DC 耦合
10/11/12	NC	悬空
1/3/4/6/7/9	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
射频/本振最大输入功率	+20dBm
中频最大输入功率	+20dBm
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
潮湿敏感等级 (MSL)	3
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏





此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按第 1 点要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。